

FBGA

J-Devicesの幅広いラインアップのFine Pitch BGA (FBGA) は、お客様の様々なニーズに対応したソリューションを提供します。

Applications

- ▶ 携帯電話、ゲーム、携帯機器、メモリ、自動車、コンピューターおよび産業向けアプリケーション
- ▶ 薄型、軽量、省スペース、低コストおよび高密度なパッケージが必要とされるアプリケーション

Thermal Performance

Body Sizes (mm)	θJA at 1.0W 0 Airflow (°C/W)		
	LFBGA	TFBGA	VFPGA
5 x 5	44.39	44.58	45.29
10 x 10	23.23	23.28	24.61
15 x 15	20.49	20.54	21.37

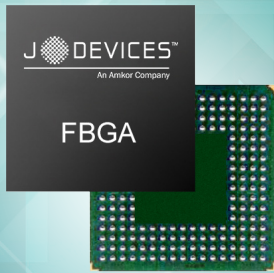
*他の熱データも準備可能です

Reliability Qualification

- ▶ 耐湿レベル：前処理条件 30°C/60% RH, 192 hours, IR reflow 260°C 3X
- ▶ 高温高湿バイアス：85°C/85% RH, 1000 hours
- ▶ 高温高湿アンバイアス：110°C/85% RH, 500 hours
- ▶ TC：-55°C/+125°C, 1000 cycles
- ▶ HTS：150°C, 1000 hours

Process Highlights

- ▶ チップ厚：0.05~0.25 mm
- ▶ マーキング：レーザーマーク
- ▶ ウェハバックグラインディング：対応可
- ▶ SMTコンポーネント：対応可
- ▶ マイクロPbフリー被覆LGAパッド/LGA：対応可



Features

- ▶ J-Devicesの標準FBGA材料を用いた低コストオプション
- ▶ ボディサイズ：3~22 mm
- ▶ 正方形、長方形のどちらにも対応可
- ▶ ボール数：25~900
- ▶ ボールピッチ：1.0~0.35 mm
- ▶ 2層/4層基板
- ▶ パッケージ高さ：0.5~1.7 mm
- ▶ 0.8、1.0 mmボールピッチ (JEDEC MO-216)
- ▶ 0.5、0.65 mmボールピッチ (JEDEC MO-195)
- ▶ 0.4 mmボールピッチ (JEDEC MO-298)
- ▶ RoHS(Green)対応
- ▶ サイドバイサイドおよびスタックタイプ等のマルチチップ対応

FBGA

Standard Materials

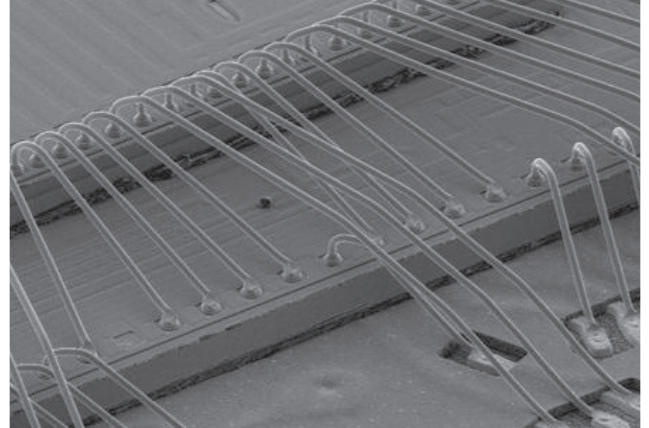
- ▶ パッケージ基板
 - ▷ 導体層：Cu
 - ▷ 絶縁層：エポキシ樹脂（ガラスクロス）
- ▶ ダイアタッチ：導電性／非導電性エポキシ
- ▶ モールド樹脂：エポキシモールド
- ▶ 低アルファ：対応可
- ▶ はんだボール：Pbフリー
- ▶ ワイヤ：Au、Cu

Test Services

- ▶ プログラム変換
- ▶ 量産エンジニアリング
- ▶ ウェハプローブ
- ▶ 256ピン x 20MHzテストシステム対応
- ▶ バーンイン対応

Shipping

- ▶ JEDECトレイ
- ▶ テープ&リール



詳細についてはamkor.comにアクセス、またはsales@amkor.com までメールをお送りください。

本文中の情報に関して、Amkorはそれが正確であることまたはかかる情報の利用が第三者の知的権利を侵害しないことについて、いかなる保証もしません。Amkorは同情報の利用もしくはそれに対する信頼から生じたいかなる性質の損失または損害についても責任を負わないものとし、また本文書によっていかなる特許またはその他のライセンスも許諾しません。本文書は、いかなる形でも販売の標準契約条件の規定を超え、いかなる製品に対しても、Amkorの保証を拡張させ、または変更することはありません。Amkorは通知することなくいつでもその製品および仕様に変更を行う権利を留保します。Amkorの名前とロゴはAmkor Technology, Inc.の登録商標です。記載されている他の全ての商標はそれぞれの会社の財産です。

© 2018 Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved. DSJD405C Rev Date: 10/18